صباح أنور سلمان تحسين حسين مبارك أسعد أحمد كامل

در اسة بعض الخواص الكهربائية لأغشية $CuIn~(Se_{0.2}Te_{0.8})_2$ و Cu In (Se_{0.8} Te_{0.2})₂ د. صباح انور سلمان د تحسین حسین مبارك اسعد احمد كامل جامعة دبالي/ كلبة العلوم

الخلاصة: CuIn (Se $_{0.8}$) CuIn (Se $_{0.8}$) و CuIn ((225±5nm) ضمن المدى الحراري (473K-300) للعينات كما تم ترسيبها وللعينات التي خضعت الى عملية التلدين عند درجات الحرارة (K) و 373) و (473 K) لمدة ساعة بوجود الفراغ (Torr-10).

تم حساب طاقات التنشيط لهذه الاغشية قبل التلدين وبعده.

Abstract:

It measuring the had been resistivity CuIn $(Se_{0.2}Te_{0.8})_2$ and CuIn $(Se_{0.8}Te_{0.2})_2$ thin films which perpetrated by vacuum thermal evaporation with a thickness of (225±5nm) in the thermal range of (300–473K) for both as deposited and annealed samples at temperatures (373K, 473K) for one hour in the existence vacuum (10⁻²Torr).

It had been calculation activation energies for these films before and after annealing.

المقدمة

 $I-III-VI_2$ هو احد مركبات المجموعة CuIn (Se_x Te_{1-x}) ان المركب الشبه موصلة. وهـو مـن المركبات المتبلورة على هيئة تركيب الجالكوباير ايت (Chalcopyrite) [1].

 $(Se_x Te_{1-x})_2$ تعتبر الأغشية الرقيقة المحضرة من المركب CuIn ذات اهمية كبيرة لملائمة خواصها البصرية والكهربائية لحقل الخلابا الشمسية [^{۲]} حيث استخدمت بشكل مكثف في مجال ابحاث الخلايا الشمسية (Heterojunction photovoltaic celles) بالاضافة الى ذلك تستخدم هذه الاغشية في تطبيقات الألكترونيات الضوئية (Photoelectronics) كاستخدامها كدايودات باعثة للضوء (L.E.D) (Light emission diodes).

الجانب العملي

تم تبخير اغشية (x=0.2, 0.8) الرقيقة عند قيم (CuIn $(Se_x Te_{1-x})_2$ الستخدام طريقة التبخير الحراري في الفراغ evaporation) المتعدد evaporation حيث تم تبخير مسحوق المركب $(Se_x Te_{1-x})_2$ المتعدد evaporation) التبلور باستخدام حويض مولبيديوم (Mo). لقد تم تحضير المسحوق بواسطة مزج نسب ذرية معينة من عناصر النحاس (Cu) والانديوم (Te) والسلينيوم (Se) المكن تحديد وزن الخليط ومن ثم وزن كل من العناصر وبموجب قيمة (x) المكن تحديد وزن الخليط ومن ثم وزن كل من العناصر الاربعة اعلاه ثم تم وضع هذه العناصر في انبوبة من زجاج الكوارتز (Quartz) مفرغة من الهواء.

تم وضع هذه الانبوبة داخل فرن كهربائي انبوبي عند درجة حرارة (1373) لمدة (75) ساعة [7]، ثم تبريد الانبوبة تدريجيا الى درجة حرارة الغرفة (R.T).

تــم اســتخدام قو اعــد مــن زجــاج البــايركس (Pyrex) لترســيب اغشــية $\operatorname{CuIn}(\operatorname{Se}_x\operatorname{Te}_{1-x})_2$ وتم قياس سمك هذه الأغشية باستخدام الطريقة الوزنية.

CuIn (Se_x Te_{1-x})₂ لاغشية (Annealing) النالدين (Annealing) المراء عملية التلدين (473k) و (473k) لمدة ساعة بوجود الفراغ.

النتائج والمناقشة

تسم اجراء القياسات الكهربائية لأغشية CuIn ($Se_{0.8}$ $Te_{0.8}$)₂ الكهربائية والتي تتضمن قياس المقاومية (ρ) خلال مديات CuIn ($Se_{0.8}$ $Te_{0.2}$)₂ حرارية من درجة حرارة الغرفة (R.T) الى درجة حرارة (473K) والتي من خلالها تم حساب طاقات التنشيط باستخدام المعادلة الاتية:

$$\sigma = \sigma_0 \exp(-E_a/K_BT) \dots (1)$$

حيث: σ التوصيلية (Conductivity)

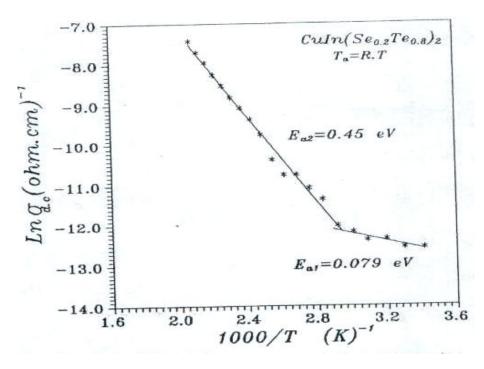
ثابت : $\sigma_{
m o}$

E. طاقة التشيط

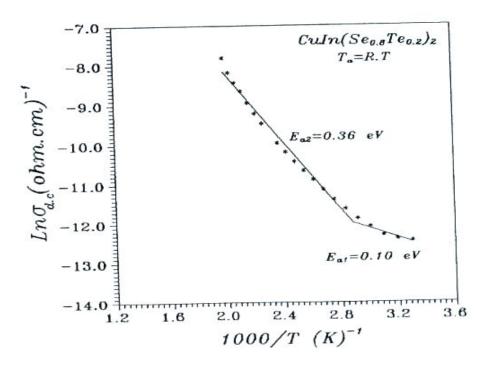
لاً: ثابت بولتزمان K_B : درجة الحرارة

توضح الأشكال من (١) الى (٦) ميكانيكية الانتقال الألكتروني وطاقات التشيط لأغشية وضح الأشكال من (١) الى (٤٥) و $\mathrm{CuIn}\ (\mathrm{Se}_{0.8}\ \mathrm{Te}_{0.2})_2$ و $\mathrm{CuIn}\ (\mathrm{Se}_{0.2}\ \mathrm{Te}_{0.8})_2$ المدة ساعة.

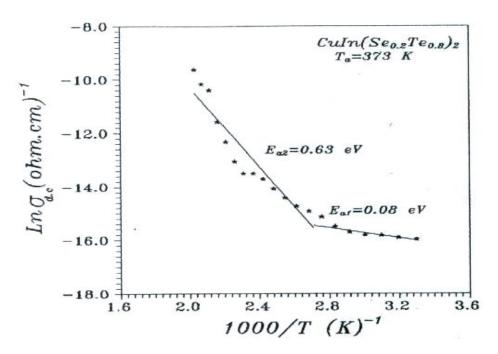
نلاحظ من خلال هذه الاشكال وجود اليتين للانتقال الالكتروني، الاولى هي عند درجات الحرارة الواطئة والتي عندها تم حساب طاقة التنشيط الاولى $(E_{\sigma 1})$ حيث يكون التوصيل هنا بطريقة القفر او الانتقاق (Tunneling) بين المستويات الموضعية داخل فجوة الطاقة الممنوعة واما الية الانتقال الالكتروني الثانية فكانت عند درجات الحرارة العالية نسبيا والتي عندها تم حساب طاقة التنشيط الثانية $(E_{\sigma 2})$ حيث ان التوصيل هنا يكون بطريقة القفز او التهيج الحراري (Thermal Excitation)



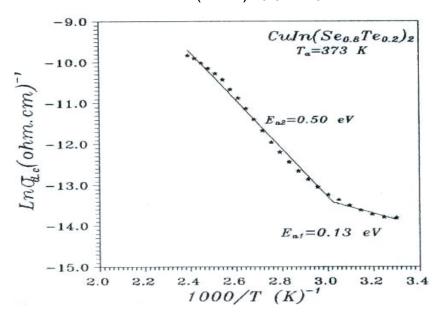
شكل (۱) العلاقة بين $cuIn~(Se_{0.2}~Te_{0.8})_2$ لغشاء 1000/T و $Ln~\sigma d.c$ الرقيق قبل التلدين



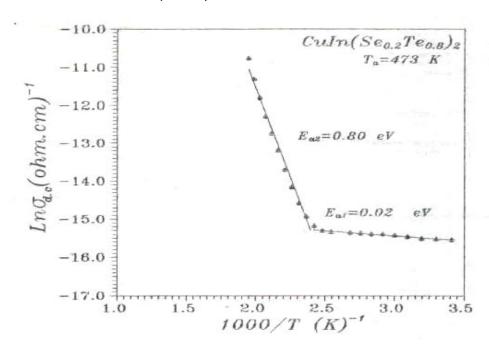
شكل (٢) العلاقة بين Ln σ d.c و $T_{0.2}$ 1000 لغشاء Ln σ d.c شكل (٢) العلاقة بين



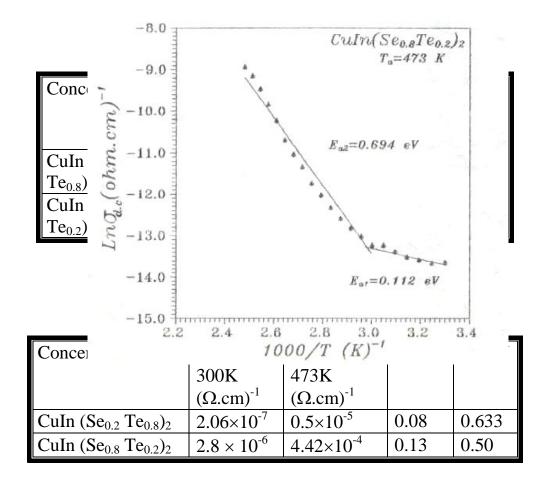
شكل (3) العلاقة بين Ln σ d.c و 1000/T لغشاء 1000/T الرقيق بعد التلدين عند درجة حرارة (373K)



بعد CuIn $(Se_{0.8} Te_{0.2})_2$ لغشاء 1000/T و $Ln \ \sigma d.c$ الرقيق بعد شكل (4) العلاقة بين التلدين عند درجة حرارة (373K)



شكل (٥) العلاقة بين $cuIn~(Se_{0.2}~Te_{0.8})_2$ لغشاء $Ln~\sigma d.c$ الرقيق بعد التلدين



شكل (6) العلاقة بين Ln od.c و 1000/T لغشاء 2018 CuIn (Se_{0.8} Te_{0.2}) الرقيق بعد التلدين عند درجة حرارة (473K)

جدول (۱) يوضح قيم التوصيلية الكهربائية المستمرة وطاقات التشيط لاغشية ${\rm CuIn}~({\rm Se}_{0.8}~{\rm Te}_{0.2})_2$ و ${\rm CuIn}~({\rm Se}_{0.2}~{\rm Te}_{0.8})_2$

جدول (٢) يوضح قيم التوصيلية الكهربائية المستمرة وطاقات التشيط لاغشية ${\rm CuIn}~({\rm Se}_{0.8}~{\rm Te}_{0.2})_2$ و ${\rm CuIn}~({\rm Se}_{0.2}~{\rm Te}_{0.8})_2$ الرقيقة بعد التلدين بدرجة حرارة (${\rm 373K}$)

جدول (3) يوضح قيم التوصيلية الكهربائية المستمرة وطاقات التشيط لاغشية ${\rm CuIn}~({\rm Se}_{0.8}~{\rm Te}_{0.2})_2$ و ${\rm CuIn}~({\rm Se}_{0.8}~{\rm Te}_{0.8})_2$ الرقيقة بعد التلدين بدرجة حرارة (473K)

Concentration	$\sigma_{d.c}$ at 300K	$\sigma_{d.c}$ at 473K	E _{al} eV	E _{a2} eV
	$(\Omega.cm)^{-1}$	$(\Omega.cm)^{-1}$		
CuIn $(Se_{0.2} Te_{0.8})_2$	1.76×10 ⁻⁶	2.98×10 ⁻⁶	0.02	0.8
CuIn (Se _{0.8} Te _{0.2}) ₂	1.18 ×10 ⁻⁶	1.79×10 ⁻⁴	0.11	0.69

يتضح لنا من الجداول (١، ٢، ٣) نقصان التوصيلية الكهربائية المستمرة لهذه الاغشية مع از دياد طاقات تتشيط الثانية بزيادة درجة حرارة التلدين وقد يعزى سبب ذلك الى ان عملية التلدين تؤدي الى زيادة انتظام الذرات في التركيب البلوري بشكل او بآخر والذي بدوره قلل من المستويات الموضعية عند حافة الحزم او زيادة فجوة الطاقة فيؤدي الى زيادة الطاقة التي تحتاجها حاملات الشحنة للانتقال الى حزمة التوصيل وبذلك تقل التوصيلية وتزداد طاقات التشيط الثانية لأغشية $\operatorname{CuIn}(Se_{0.8})$ و $\operatorname{CuIn}(Se_{0.8})$ و $\operatorname{CuIn}(Se_{0.8})$

ونلاحظ ايضا من خلال الجداول (١، ٢، ٣) بان التوصيلية الكهربائية المستمرة تزداد بزيادة نسبة السلينيوم في الاغشية وللحالتين قبل التلدين وبعده مما يؤدي الى حاجة حاملات الشحنة الموجودة في حزمة التكافؤ الى طاقة قليلة لعبور فجوة الطاقة ووصولها الى حزمة التوصيل ولهذا فأن قيم طاقات التشيط الثانية تقل بزيادة نسبة السلينيوم في الاغشية وللحالتين قبل التلدين وبعده [2,6,7].

الاستتناجات

- CuIn $(Se_{0.2} Te_{0.8})_2$ المستمرة لاغشية المهربائية المهربائية المستمرة العشية CuIn $(Se_{0.8} Te_{0.2})_2$ الرقيقة بزيادة درجة الحرارة وهذه ميزة من مميزات اشباه الموصلات حيث يزداد تركيز حاملات الشحنة بازدياد درجة الحرارة.
- ٢- لوحظ بوضوح وجود اليتين للانتقال الالكتروتي احداهما عند درجات الحرارة الواطئة نسبيا والاخرى عند درجات الحرارة العالية نسبيا للعينات التي لم تلدن وتلك التي تم تلدينها.
- ٣- نقصان التوصيلية الكهربائية المستمرة للاغشية كافة مصاحبا ذلك ازدياد طاقات
 التنشيط الثانية بزيادة درجة حرارة التلدين.
- ٤- ازدياد التوصيلية الكهربائية المستمرة للاغشية كافة مصاحبا ذلك نقصان طاقات التشيط الثانية بزيادة نسبة السلينيوم في الاغشية وللحالتين قبل التلدين وبعده.

References

 M. Leon "Preparation and some semiconducting properties of CuIn (Se_x Te_{1-x})₂ thin films grown by triode sputtering" Eighth E. C. photovoltaic solar energy conference. Proceedings of the international conference, helt at Florence, Italy, 9-13 May, Vol. 2, (1988), P. 1077.

- 2. R. Diaz "Preparation and some semiconducting properties of CuIn (Se_x Te_{1-x})₂ Thin films grown by thermal evaporation" Eighth E.C. photvoltaic solar energy conference. Proceedings of the international conference, helt at Florence, Italy, 9-13 May, Vol.2, (1988), P. 1075.
- 3. F. Rueda "Composition effects in flash evaporated of CuIn (Se_x Te_{1-x})₂ thin films" J. Vac. Sci. Technol. A 12 (6), Nov./ Dec., (1994), P. 3082.
- 4. R. A. Smith "Semiconductors" 2nd edition, (1987).
- 5. R. Fowles "Introduction to Modern Optics" 2nd edition, (1975).
- 6. R. J. Eiliott and A. F. Gibson "Introduction to solid state physics and its applications" (1974).
- 7. C. Kittle "Introduction to solid state physics" 5th edition, (1976).